

<b>信越化学工業株式会社 2018年3月期 決算説明会要旨</b>	
<b>日 時</b>	2018年4月27日(金) 16:00 - 17:00
<b>開催場所</b>	朝日生命大手町ビル 27階
<b>会社側出席者</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・代表取締役 会長 金川 千尋</li> <li>・代表取締役 社長 斉藤 恭彦</li> <li>・専務取締役 研究開発、新機能材料事業担当 石原 俊信</li> <li>・専務取締役 シリコン事業本部長 上野 進</li> <li>・専務取締役 半導体事業担当 轟 正彦</li> <li>・常務取締役 広報担当 秋本 俊哉</li> <li>・取締役 経理部長 笠原 俊幸</li> <li>・広報部長 足立 幸仁</li> </ul>
<b>説明資料</b>	<a href="#">2018年3月期 決算説明資料</a>

\* このメモは決算説明会でお話しした内容をまとめたものです。

### 【挨拶 (会長 金川千尋)】

- ・ 2018年3月期は8期連続の増益で過去最高益を達成。
- ・ 増益を大きく牽引したのは、米国シンテック社を中核とする塩ビ事業、半導体事業、シリコン事業。そのほかのセグメントも二桁の増益を達成。
- ・ 2018年3月期の配当金は、前年度より20円増配の140円を予定。
- ・ (引き続き)市況の変動を見ながら全世界での販売に注力。同時に健全な財務を活かしながら積極的な投資を進め事業の拡大を目指す。

### 【決算概要説明 (社長 斉藤恭彦)】

- ・ 当期(2018年3月期)の純利益の中には、米国の税制改正による繰延税金負債の取り崩しが約300億円含まれる。
- ・ 各セグメントの主たる増益要因：塩ビ・化成品事業はスプレッドの改善、半導体シリコン事業は製品価格の修正・値上げ、その他事業は数量効果によるもの。
- ・ 4.5百万株の自社株式の消却を決定。5月2日に実施予定。
- ・ 当期 ROIC は4ポイント上昇し18%、ROE は3ポイント上昇し12%。
- ・ 当期の設備投資額は1,762億円(期初予定では1,800億円)、今期(2019年3月期)は約2,500億円の予定で、各事業での新設増設が主たる増加要因。
- ・ 今期の通期業績予想、配当予想の発表は、開示が可能になった時点で行う(例年通りのタイミングになる見込み)。

## 【決算詳細説明（取締役経理部長 笠原俊幸）】

- ・ 当期の減価償却額は1,120億円、2019年3月期は1,350億円の予定。
- ・ 19年3月期の計画（投資、償却）の前提となる海外子会社の換算レートは、1US\$ = 105円、1€ = 130円。
- ・ 営業利益の為替感応度はUSドルで24億円、€で3億円。
- ・ （当期の設備投資額）セグメント別内訳
  - 塩ビ・化成品事業（636億円）は、米国シンテック社のエチレン工場の建設が中心。
  - シリコン事業（291億円）は、半分近くが海外における投資。
  - 機能性化学品事業（70億円）、半導体シリコン事業（515億円）、電子・機能材料事業（202億円）、加工・商事・技術サービス事業（50億円）
- ・ （当期の減価償却額）セグメント別内訳
  - 塩ビ・化成品事業（329億円）、シリコン事業（122億円）、半導体シリコン事業（324億円/前期比約120億円増は、当期の設備投資が増加したことによる。）、機能性化学品事業（101億円）、電子・機能材料事業（201億円/前期比約30億円増は、前期に設備投資が増加したことによる。）、加工・商事・技術サービス事業（43億円）
- ・ 比較損益計算書〈連結〉
  - 販売費・一般管理費（1,416億円/前期比113億円増は、主に販売数量増加による運搬費の増加。）
  - 法人税・住民税・事業税（702億円）は、米国税制改正による一時的な繰延税金負債の取り崩しによる税金の減少があり、表面的な税前利益に対する税率は20.6%。その一時的な要因を除くと税率は29.4%。  
19年3月期以降、米国減税が恒常的に続いた場合、18年3月期の利益構成で考えると税率は26%程度になる見込み。
- ・ 比較貸借対照表〈連結〉
  - 前期末との比較で、海外子会社換算における為替変動の影響は、USドルは円高方向、€は円安方向のため、プラスマイナスが入り混じっている。
  - 受取手形売掛金（3,328億円/前期末比427億円増は、売上の増加による。）
  - 有形固定資産（8,997億円/前期末比571億円増は、建設仮勘定が約340億円増加。シンテックのエチレンプラント建設費が主なもの。）
  - 流動負債のその他（1,798億円/前期末比316億円増は、主には建設工事に係る未払い金や手形の増加による。）

## 【質疑応答】

### 〈塩ビ・化成品〉

Q	塩ビ・化成品の4Qの利益が大幅に増えた要因について。
A	2017年は四半期ごとにスプレッドが改善しました。地域毎の需要については、その時々で強弱ありながらも全般的に伸びました。
Q	米国での塩ビ樹脂増強の考え方について。
A	建設許可は間もなくでると思います。能力増強の規模や建設期間については、改めて発表します。か性ソーダの需給も勘案のうえ、電解の増強も検討しています。
Q	米国でのエチレンプラント建設の進捗について。
A	着々と工事は進行しており、現時点では、2018年末に完成する予定です。
Q	18年の塩ビ、か性ソーダの需給について。
A	足元まで販売は順調です。シンテックは、18年1-3月において、寒波により一時的に操業に影響が出て、数量は若干減りましたが、値上げにより、1-3月の売上は、17年1-3月よりも増えています。5月の販売も仕上がっており、半年は大丈夫と見ています。残り半年はこれからですが、顧客に話を聞く限りは、今年は大丈夫そうです。か性ソーダも引き続き堅調に推移しています。

### 〈半導体シリコン〉

Q	半導体シリコンの設備投資額について。
A	2017年度半導体シリコンの設備投資額は515億でした。 例年の基礎的な投資に加え、次の4点を実施しました。 ① 300mmを中心とした高品質化対応、② 300mm逐次増設のための準備（建屋の改装や装置の入れ替え、ユーティリティの整備など）、③ デボトル解消と歩留り向上対応、④ 200mmで今後伸長が期待される高速通信や省エネデバイス向けへの対応です。 今年度については、前年比で約3割増を見込んでいます。
Q	ウエハーの需給関係について。
A	・(300mm)：メモリーは好調持続、ロジックはスマホ関連向けの調整が一部入ったことにより、デバイスメーカーの中で強弱があります。ただ、ユーザーに

	<p>おけるウエハー在庫は薄いため、状況に大きな変化はありません。業界全体で見ても、需給は逼迫しているとみています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・(200mm) : 2015年10-12月をボトムに2年以上好調が継続。IoT、自動車電装化、産業用ロボットなどが需要をけん引しています。全ウエハーメーカーがフル稼働を続けていると見ています。</li> <li>・(150mm以下) : 2017年(暦年ベース)はシリコンウエハー全体で10%(数量ベース)伸びましたが、150mm以下はそれを上回る伸長率となり、全ウエハー径の中で一番数量が伸びました。200mmで作り切れないデバイスを150mm以下で補ったことや、ディスクリートを手掛けるメーカーの稼働が上がったことが要因と思われます。</li> </ul>
Q	ウエハーの中長期的な見通しについて。
A	<p>半導体産業は、スーパーサイクルに入ったという見方もあります。10年前はウエハーの需要はPCが中心でしたが、5-6年前からスマホが大きく伸び、足元ではスマホが主力となっています。ここにきて需要構造が変わりつつあり、IoT、AIを活用したシステム、自動車の高機能化、人手不足に対応するロボット化など、特定のセグメントには左右されない構造になりつつあります。</p> <p>これら新しい産業は、①マクロ景気の動向や国の政策の影響 ②初期需要の発生があるため、先々の動向を注視していく必要があります。</p> <p>また今後メモリーを活用した様々なシステムが作られようとしています。メモリーが大量に使われるデータセンターの建設も旺盛に行われています。メモリーはDRAM、NANDに大別されますが、DRAMの微細化動向や、NANDの3D化の進展とその歩留りを注視していく必要があります。</p>
Q	ウエハーの値戻しの状況について。
A	<ul style="list-style-type: none"> <li>・当社で言えば、値戻し前(2016年10-12月)の価格を基準にすると、2017年10-12月は、全ウエハー平均で約2割上がりました。</li> <li>値上げ幅は、年初から交渉が始まった300mmが最も大きく、次いで春先から交渉の200mmの順です。150mmは秋口から交渉を始めました。</li> <li>・2018年10-12月は、今後の交渉や、為替の動向もありますが、2016年10-12月と比べ3-4割の上昇と見ています。(2018年の値上げ率は)契約が各社各様で一概に言えませんが、(全体では)18年の値上げ率は17年に比べ少しなだらかくなる傾向と思います。</li> <li>・2020年の価格はまだはっきり見えていません。グリーンフィールドからの投資になれば、値上げの上昇幅は大きくなります。</li> </ul>

Q	2018年から2020年にかけての長期契約の状況について。
A	300mmの契約の割合は、2018-2019年は90%以上となっています。2020年の契約の割合は、現時点では6割強となっています。
Q	ウエハー業界の能力増強について。
A	ウエハー関連装置は長納期化しており、これから発注しても生産に寄与するのは2020年後半と思われます。当社における既存の逐次増設分の寄与については、今年の秋口からの予定です。
Q	業界での300mmの生産能力について。
A	各社、生産性向上の取り組みを行っていると思われるので、その結果として少しずつ能力が上がっていくと見ています。
Q	シェアに関する考え方について。
A	シェアは目的ではなく、あくまでも結果と考えています。
Q	ロジック向けウエハーの需要動向について。
A	足元のロジックデバイス調整は、スマホ向けが一つの要因と見ています。仮想通貨用マイニング向けロジックデバイスは足元好調と聞いていますが、先行きについては良く分かりません。ただブロックチェーン技術については他の用途も期待されています。

### 〈電子・機能材料〉

Q	本セグメント4Q業績の堅調の要因について。
A	半導体材料が安定していたことと、レア・アースマグネットが車載中心に伸びたことが下支えとなりました。

### 〈全 社〉

Q	自己株式の消却について。
A	保有している自己株は、買収案件の内容に応じて株を充てることを考えていましたが、現在の手持ち資金の水準から、保有の必要性が薄れたため、消却を決めました。

Q	今後の株主還元について。
A	自己株買いは選択肢として認識していますが、現時点で計画はありません。基本は、配当を安定的に行うことで、株主還元を続けていきたいと考えています。